

HIFLON

NISSEI HIFLON™ CABLE ASSEMBLY MID for CABLE ASSEMBLY

特徴

- 3次元の配線を活かした豊富なアプリケーション
- 省スペース化, 軽量化, 部品点数削減に貢献
- 自社一貫生産によりカスタム要求に対応

3D配線による豊富なアプリケーション

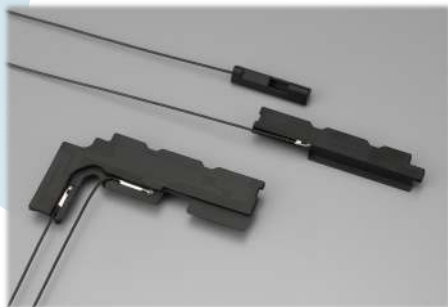
Extensive applications with 3D patterning



タッチセンサ実装モジュール



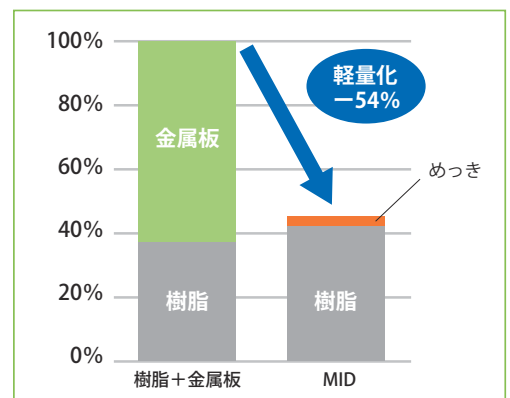
シールド機能付きコネクタカバー



LTE・Wi-Fi・Bluetooth Antenna



MIDの特徴を活かして
省スペース化・部品点数削減を実現

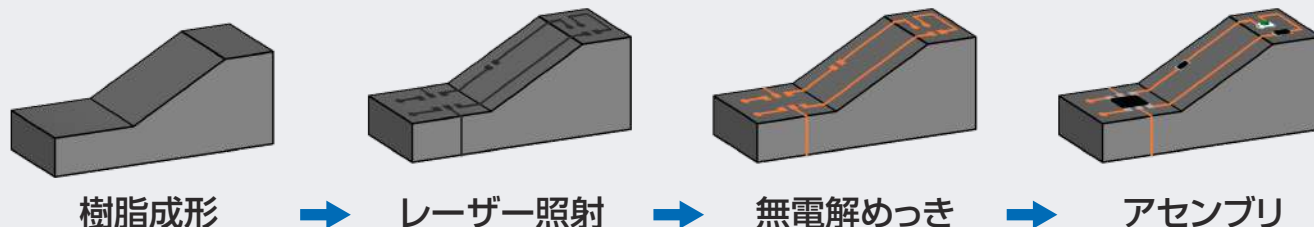


NISSEI ELECTRIC CO.,LTD.

MID for CABLE ASSEMBLY

MID (Molded Interconnect Device)

MIDは、樹脂成形品や筐体に3次元配線を直接形成することで、電子機能と構造の一体化を実現する技術です。小型化、軽量化、工程削減に貢献します。当社が採用しているLDS工法は専用樹脂にレーザーで回路を描き、選択的にめっきを施すことで自由な設計を可能にします。



材質

〈樹脂基材〉

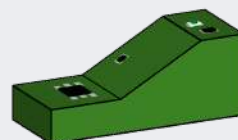
- ポリアミド、ポリカーボネート等

〈回路〉

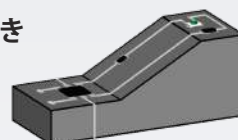
- 無電解銅めっき

表面仕上げ

- ソルダーレジスト



- 無電解ニッケルめっき
(ソルダブル)



対応可能サイズ

- D, W:150mm未満 H:30mm未満
- 銅めっき厚さ：10 μ m
- 曲面斜面配線可

基本特性(例)

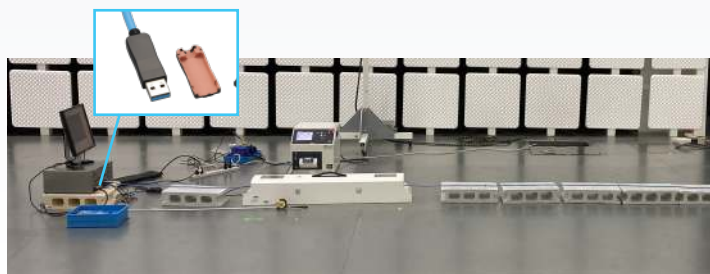
ランド引張剥離強度 1.2N/mm²

回路面粗度 Ra 2 μ m

実施例

〈シールド機能〉

ファスト・トランジェント/バースト試験
レベル3合格 (従来金属板シールド同等)



MIDにご興味のある方、是非お問い合わせください。

日星電気株式会社

本社：〒432-8006 静岡県浜松市中央区大久保町1509番地
URL：<https://www.nissei-el.co.jp>

東京営業部 〒115-0055 東京都北区赤羽西1丁目7番1号バルロード3 8F
TEL:03-5963-5577(代)

町田営業部 〒194-0045 東京都町田市南成瀬1丁目2番地2号OSJ成瀬ビル 5F
TEL:042-729-2531(代)

名古屋営業部 〒465-0046 愛知県名古屋市名東区望ヶ丘281番地
TEL:052-777-2771(代)

浜松営業部 〒432-8006 浜松市中央区板屋町111-2 浜松アクトタワー27F
TEL:053-485-7227(直)

大阪営業部 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3丁目19番地40号日星ビル
TEL:06-6386-6750(代)

福岡営業所 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-11-26 井門博多駅前ビル5階